

真的会这样吗?

日本の凋落 - 目次



一些用语

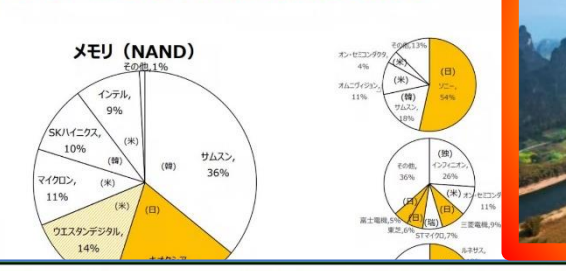
- ▶ IP: 英: ARM
- ▶ EDA (electronic design automation, 美国, 德国)
- ▶ IDM; Integrated Device Manufacturer (IDM)
垂直統合型デバイスメーカー(設計製造販売一体化)
- ▶ Fabless Model: 无制造工厂型, 工水平分業型
- ▶ Design House, IC设计公司) + Subcon (SUBCONTRACTOR)
FOUNDARY, OSAT
- ▶ FOUNDARY 晶圆代工
- ▶ OSAT; OUTSOURCED SEMICONDUCTOR ASSEMBLY

Wafer ウェハ

代表的なIDM企業

<p>・インテル 設立: 1968年 本社: 米国カリフォルニア 代表者: パット・グルンツァー</p> <p>主要製品 マイクロ PC用CoreシリーズCPU サーバー向けXeonシリーズCPU モバイル向けAtomシリーズCPU等</p>	<p>・キオクシア 設立: 2019年 (東芝メモリから社名変更) 本社: 日本東京都 代表者: 早坂伸夫</p> <p>主要製品 メモリ NANDフラッシュ SSD等</p>
<p>・サムスン電子 設立: 1969年 本社: 韓国水原市 代表者: イ・ジェヨン</p> <p>主要製品 メモリ DRAM NANDフラッシュメモリ ロジック SoC, システムLSI等</p>	<p>・ルネサスエレクトロニクス 設立: 2011年 本社: 日本 代表者: 柴田英利</p> <p>主要製品 マイクロ ロジック ディスプレイ</p>

半导体产业之芯片市场及各大公司份额



ファウンドリ企業ランキング

2021年第2四半期 (出典: TrendForce) ※略してGF

順位	企業名 (本社)	シェア (%)
1位	TSMC (台湾)	52.9
2位	サムスン電子 (韓国)	17.3
3位	UMC (台湾)	7.2
4位	グローバルファウンドリーズ (米国)	6.1
5位	SMIC (中国)	5.3
その他		11.2

- ・トップのTSMCがシェアの過半を握る圧倒的地位
- ・2位のサムスン電子は自社製品のみならずファウンドリ事業も手掛け、TSMCを追い上げ
- ・3位のUMCもTSMCと同様にファウンドリ直営、先端プロセス以外のプロセスで勝負

Semiconductor Process from Wafer to Module



【半導体製造メーカーとは?】売上高ランキングと事業形態について解説 | 半導体業界ドットコム (semiconductor-industry.com)

半導体製造メーカー売上高ランキング推移

(出典: IC Insights)

国別	日本	米国	欧州	韓国	台湾	事業形態: 1 IDM	2 ファウンドリ	3 ファブレス
1位	NEC	インテル	インテル	インテル	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
2位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
3位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
4位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
5位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
6位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
7位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
8位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
9位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子
10位	日立	IBM	IBM	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子	サムスン電子

・1990年には上位10社中、日本企業が6社がランクインしていたが、その後は減少 (2021年では上位10社中1社にランクインする企業はなし、最高位はキオクシアが15位)
・2021年では上位10社中、米国企業が6社、韓国企業が2社、台湾企業が2社
・2010年代以降はファブレス企業、ファウンドリ企業が上位に躍進

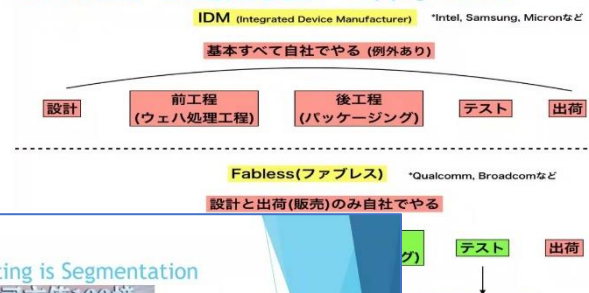
半導体市場と产业链の基礎知識

2023年09月10日

勉強会第34講

2022年9月宁波商会学习会
 主持人: 宁波商会理事舒朝军
 2022年9月10日

芯片制造产业链概念图: Supply Chain



2021年全球半导体公司市值100榜

Market is Segmentation

排名	公司名称	公司标志	市值 (亿元)	国家或地区
1	台积电	TSMC	37,552.00	中国台湾
2	英伟达	NVIDIA	33,587.89	美国
3	阿斯麦	ASML	19,801.79	荷兰
4	英特尔	Intel	14,053.20	美国
5	博通	Broadcom	12,945.19	美国
6	德州仪器	TI	11,510.91	美国
7	高通	Qualcomm	10,410.48	美国



这样的排名只是说明这些公司在这个行业里
 没有信息表明他们在做什么, 以及在产业链中的位置

・キオクシア
 設立: 2019年 (東芝メモリから社名変更)
 本社: 日本東京都
 代表者: 早坂伸夫

主要製品
メモリ NANDフラッシュ
SSD等

・ルネサスエレクトロニクス
 設立: 2010年 (ルネサステクノロジとNECエレクトロニクスが経営統合)
 本社: 日本東京都
 代表者: 柴田英利

主要製品
マイクロ RA, RZシリーズマイコン
ロジック 車載用SoC (R-Car)
ディスプレイ 車載用パワーデバイス等

製造メーカー売上高ランキング

(出典: IC Insights)

・売上高100億ドル超え企業は17社

・本社国別
 米国: 9社
 欧州: 3社
 台湾: 2社
 韓国: 2社
 日本: 1社

・事業形態別
 IDM企業: 10社
 ファブレス企業: 6社

2020年全球前十大IC設計業者营收排名					1Q22全球前十大晶圆代					3Q21全球前十大封測厂家营收排名								
排名	公司名称	总部	2020营收 (百万美元)	2019营收 (百万美元)	YoY	排名	公司	总部	2021营收 (百万美元)	2020营收 (百万美元)	YoY	排名	公司	总部	2021营收 (百万美元)	2020营收 (百万美元)	YoY	
1	高通(Broadcom)	美国	18,407	14,518	39.70%	1	台积电(TSMC)	中国台湾	1,148	1,148	24.20%	41.30%	1	日月光(M ASE)	中国台湾	2,148	2,420%	41.30%
2	博通(Broadcom)	美国	17,745	17,246	2.90%	2	三星(Samsung)	韩国	2,148	1,880%	24.20%	24.20%	2	安森美(Analog)	美国	1,681	1,880%	24.20%
3	英伟达(Nvidia)	美国	15,412	10,125	52.20%	3	联电(UMC)	台湾	1,392	1,410%	27.80%	27.80%	3	矽品(SPI)	中国台湾	1,036	11.70%	15.60%
4	联发科(MTK)	中国台湾	10,929	7,982	37.30%	4	格芯(Globalfoundries)	美国	1,036	1,036%	24.20%	24.20%	4	矽品(SPI)	中国台湾	1,036	11.70%	15.60%
5	展讯(SAMSUNG)	美国	9,763	6,781	45.00%	5	中芯国际(SMIC)	中国	802	9.00%	24.00%	24.00%	5	力成(LITE)	中国台湾	802	9.00%	24.00%
6	赛灵思(Xilinx)	美国	3,053	3,234	-5.60%	6	华虹集团(Hua Hong)	中国	636	7.20%	59.80%	59.80%	6	通富微电(TFMC)	中国	636	7.20%	59.80%
7	美满(Marvell)	美国	2,942	2,708	8.70%	7	力积电(PSMC)	中国台湾	502	5.80%	57.80%	57.80%	7	天华电子(Hua Tian)	中国	502	5.80%	57.80%
8	联发科技(Mediatek)	中国台湾	2,712	2,065	30.10%	8	世界先进(VIS)	中国台湾	323	3.60%	28.50%	28.50%	8	京元电子(KYEC)	中国台湾	323	3.60%	28.50%
9	展讯(SAMSUNG)	美国	2,635	1,965	34.10%	9	合泰集成(Neochips)	中国台湾	257	2.90%	32.50%	32.50%	9	南茂(OligoMOS)	中国台湾	257	2.90%	32.50%
10	展讯(SAMSUNG)	美国	1,376	1,421	-3.20%	10	高塔半导体(TowerJazz)	中国	255	2.90%	29.50%	29.50%	10	顺络(Sunlord)	中国	255	2.90%	29.50%

高电子饱和速率及抗辐射能力等优异性能, 更适合于制作高温、高频、抗辐射及核能领域的“核芯”, 在半导体照明、新一代移动通信、能源互联网、类电子等领域有广阔的应用前景, 有望突破传统半导体技术的瓶颈, 与第一代、第二代节能减排、产业转型升级、催生新的经济增长点将发挥重要作用。第三代半导体材料是目前全球也是我们国家的重点扶持行业。十二五期间, 863计划重点支持了“第三代半导体器件制备及材料: 氧化镓(Ga2O3)

半导体材料, 氧化镓(Ga2O3) 由于自身的优异性能, 凭借其比第三代半导体材料SiC和GaN更宽的禁带, 半导体材料, 氧化镓吸引了越来越多的关注和研究。氧化镓是一种宽禁带半导体, 禁带宽度Eg=4.9eV, 其良好, 因此, 其在光电子器件方面有广阔的应用前景, 被用作Ga基半导体材料的绝缘层, 以及氮氧化镓的传统应用领域, 而其在未来的功率、特别是大功率应用场景才是更值得期待的。丰富多彩, 除了上述典型材料, 还有有机半导体、陶瓷半导体等材料, 它们具有其独特的性质和应用。